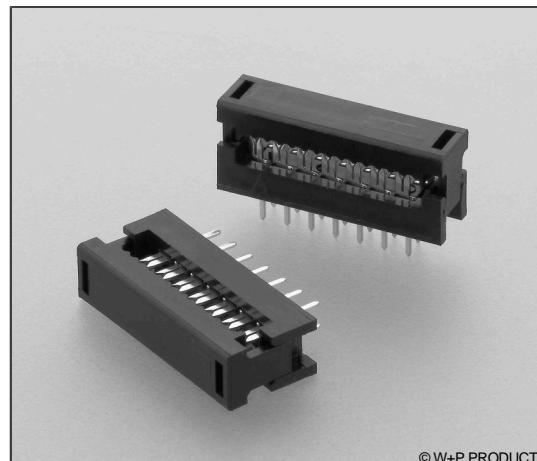


IDC Leiterplattenverbinder RM 2,54mm – Bauhöhen 7,5 / 6,0mm IDC Printed Circuit Connectors, 2.54mm Pitch – 7.5mm / 6.0mm Profiles

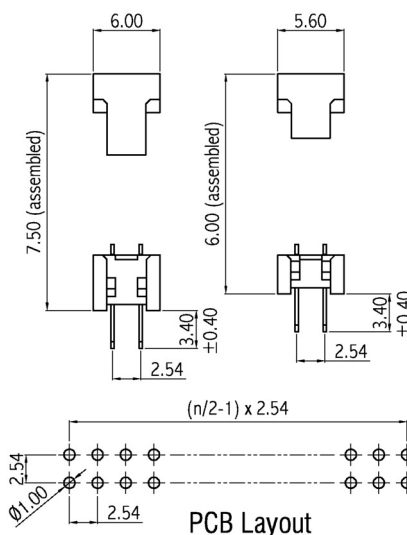
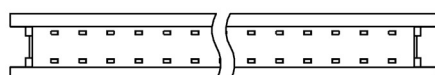
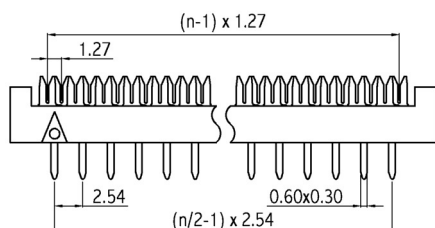
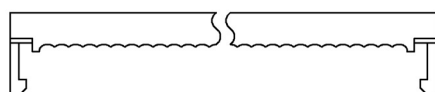
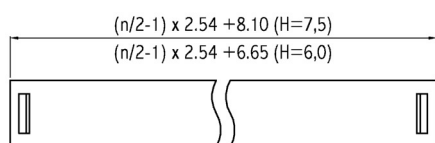
Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni <i>Acc. to options (see below), over Ni</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500 V AC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40 °C ... +105 °C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellenlötverfahren <i>Wave soldering</i>



© W+P PRODUCTS

Passende Flachbandkabel:
Compatible Flat Cables:
3560-1-287-xx



PCB Layout

Series	Contacts*	Plating*	Height*	Colour (Optional)
140	64 08/10/14/16/18 20/22/24/26/28 30/34/40/50 60/64	60 50 Verzinkt (Standard) Tin plated (Standard) 60 Sel. Au/Sn (Standard) Duplex Plating (Standard) 00 Vergoldet (auf Anfrage) Gold plated (on request)	7,5 7,5 H=7,50 B=6,00mm 6,0 H=6,00 B=5,60mm	[] [] Standard: Schwarz Standard: Black 6 Grau Grey

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Informationen zum Wellen-Lötverfahren

Wave Soldering Information

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.

Empfohlenes Wellenlötprofil:

